

AI+半導體封裝測試人才培育及技術交流會

台灣半導體產業鏈產值達新台幣 2.46 兆，全球排名第三，在專業晶圓代工製造領域更長期獨占鰲頭。另外台灣封裝測試產業全球市占高達 50 %以上，產值達 4477 億元，就業人口超過 9 萬人。台灣的封測業可望憑藉半導體群聚的優勢，發展出高階封測核心的競爭力。

台灣的封測公司正在進行新一波的智慧封裝測試產業革命，以「智慧製造」技術為核心，結合「智慧感測系統」和「智慧資料分析」，研發相關的封裝測試設備與環境。維持生產線運作之核心除了技術、製程與品質之外，背後資訊系統之運作及生產管理手法之應用，也是提升競爭力的重要關鍵因素，因此也與「精實生產管理」及「大數據分析」緊密連結，甚至導入「人工智慧」技術，藉由深度學習提高製程的良率。

本技術交流會邀集半導體封裝測試產業相關的產官學研專家學者相聚，藉由專題演講、公開討論進行「人工智慧」與「半導體封裝測試」技術交流以及人才之培育。

- 活動時間：2019 年 05 月 15 日（星期三）09:00-17:00；
- 活動地點：明新科技大學 鴻超樓 B1 多功能講堂
- 活動對象：半導體封裝測試業界先進；大專、高中職學校師生等
- 報名方式：線上報名，報名網址為：<https://goo.gl/forms/d56gx3PkphMYE8zh3>

時程表

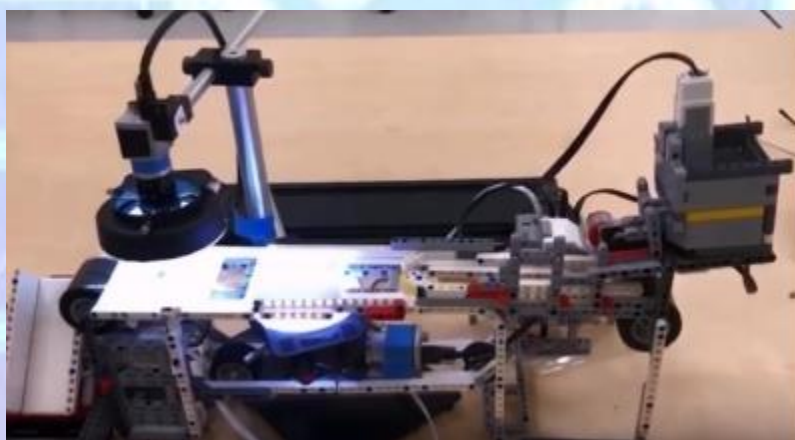
時間	活動內容	講者
09:00~09:30	報到	
09:30~09:35	介紹長官、來賓	
09:35~09:50	致歡迎詞	明新學校財團法人明新科技大學 林啟瑞校長
10:00~10:20	國際產學聯盟 GLORIA 計畫簡介	國立清華大學 張益祥資深協理
10:20~11:00	半導體產業及 GPM 產品介紹	均豪精密工業股份有限公司 張書省副處長
11:10~12:00	智慧城市推廣與案例分享	神通資訊科技股份有限公司 丘金勝副總經理
12:00~13:30	午宴 現場人工智慧作品展示觀摩	

13:30~14:00	MUST 的半導體封裝測試實務人才培育計畫	明新學校財團法人明新科技大學 工學院呂明峰院長
14:00~15:00	跨領域 AI 人才培育模式與案例分享	財團法人資訊工業策進會 數位教育研究所 數位轉型訓練中心葉宗翰主任
15:00~15:20	Break (Tea Time)	
15:20~16:00	1. CNN 及其在腦瘤偵測之運用 2. 人工智慧在半導體封裝檢測之應用	明新學校財團法人明新科技大學 電子系莊正教授 (經濟部工業局「產業出題・人才 解題」得獎團隊)
16:00~16:30	綜合討論	
16:30	賦歸	

承辦單位： **明新科技大學**
Minghsin University of Science and Technology 明新學校財團法人明新科技大學(優化技職校院實作環境計畫)

指導單位：教育部產學連結合作育才平台執行辦公室-光電半導體工作

協辦單位： **MOST 科技部**
Ministry of Science and Technology 科技部、 **GLORIA**
Global Research & Industry Alliance 清華大學國際產學聯盟 GLORIA、
新竹縣政府、教育部電機電子群科中心、均豪精密工業股份有限公司、
矽格股份有限公司、神通資訊科技股份有限公司、力成科技股份有限公司。



人工智慧咖啡豆分類機